

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務—我們的成長戰略」。

[編纂]

我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的估計[編纂]及其他費用及開支後，[編纂]的[編纂]將約為[編纂]港元，假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元（即[編纂]每[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數）及[編纂]未獲行使。

我們目前擬將[編纂]的[編纂]用作以下用途及金額：

- (1) [編纂]約[編纂]（或[編纂]港元）將用於擴充我們的FCBGA產能。

根據弗若斯特沙利文的資料，由2025年至2030年，全球IC載板市場預期將達303億美元，複合年增長率為15.3%。FCBGA載板預期將成為IC載板市場中增長最快的分部。由2025年至2030年，全球FCBGA供需比率預期將由2025年的94.7%上升至2026年的104.7%，超過100%進入供應短缺狀態，其後差距將持續擴大，並於2030年達到125.6%。

作為IC載板行業的技術領導者，我們策略性地專注於FCBGA載板作為未來的增長動力。領先客戶在選擇像我們這樣的IC載板生產合作夥伴時，會高度重視合作夥伴的產能爬坡能力。有關更多詳情，請參閱「業務—我們的競爭優勢」。

用於擴充FCBGA產能的[編纂]將按以下方式應用：

- (i) [編纂]約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於建設生產設施及相關機電安裝工程。具體而言：
- (A) [編纂]約[編纂]%（或[編纂]港元）用於建設生產設施，包括但不限於專用生產廠房及多層級潔淨室，該等設施按激光鑽孔、精細線路曝光、VCP電鍍、微球植球及3D視覺檢測等製程的嚴格生產環境控制要求進行設計。
- (B) [編纂]約[編纂]%（或[編纂]港元）用於相關機電安裝工程，包括但不限於全廠公共設施工程、潔淨室空調系統、末端配電、製程氣體管道及化學品管道。
- (ii) [編纂]約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於採購FCBGA生產流程所用的設備。具體而言：
- (A) [編纂]約[編纂]%（或[編纂]港元）用於採購內層線路及鑽孔階段的設備，包括但不限於通孔電鍍、水平電鍍、芯層曝光及顯影、蝕刻及剝膜工藝等設備。

未 來 計 劃 及 [編 纂] 用 途

(B) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購外層線路階段的設備。具體而言：

(I) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購激光鑽孔設備，用於在半導體載板上鑽盲孔及微孔開窗，包括但不限於CO₂激光鑽孔機及相關自動投、收等設備。

(II) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購外層線路成形及電鍍工藝所用的設備。具體而言：

(a) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購外層線路生產擴充及自動化所用的設備，包括但不限於ABF壓合設備、半加成工藝除膠渣、增層激光直接成像曝光及顯影等設備。

(b) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購外層線路電鍍工藝所用的設備，包括但不限於半加成工藝化學鍍銅系統、垂直連續電鍍銅及等離子處理系統等設備。

(C) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購防焊、表面處理及微球植球階段的設備，包括但不限於防焊壓合、曝光及顯影系統及微球植球及回流焊系統等設備。

(D) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)用於採購成型及檢測階段的設備，將包括量產治具電測系統、單顆電測系統及相關自動投、收系統。

(2) [編纂]約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]的[編纂]高於或低於上述分配所假設的金額，我們擬按比例調整[編纂]用於上述用途的分配。

倘我們的任何計劃因政府政策變動(致使我們的任何項目開發不可行)、市況變動或發生不可抗力事件等原因而未按預期進行，我們將審慎評估情況，並可能將[編纂]重新分配至我們認為合適且符合我們及股東整體最佳利益的其他用途。在此情況下，我們將遵守上市規則下的適用要求。

在[編纂]未即時用於上述用途的情況下，且在適用法律法規允許的範圍內，我們將僅把[編纂]存入持牌商業銀行及／或授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。